



国際宇宙ステーション
JAXA こうのとりHTVと
カナダアーム

性能向上型 Dサブ

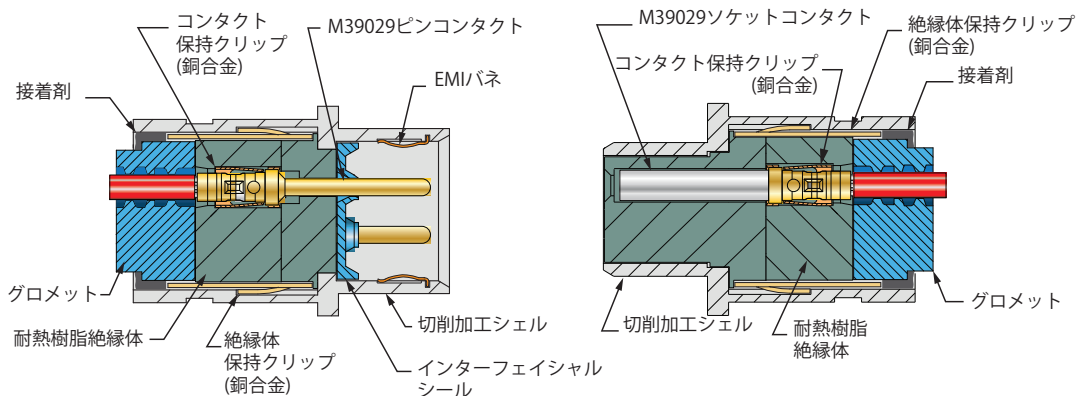
HiPer-Dコネクタ

宇宙グレードMIL-DTL-24308互換

Glenair HiPer-D コネクタは、MIL-DTL-24308準拠のDサブコネクタで、より優れた性能を持っています。プレス加工で組立られた通常のDサブとは異なりHiPer-Dコネクタは、切削一体加工シェルでできており、定格200°Cの連続使用温度の性能とコネクタ内蔵のEMIバネによるEMI保護性能を持っています。また、耐環境性保護として、航空宇宙グレードシリコンゴムのグロメットやインターフェイスシール(アウトガス処理対応可能)を採用しております。このHiPer-Dコネクタは、MIL-DTL-24308規格Dサブコネクタと互換性があります。

- 温度性能・振動・EMIシールド/電気的特性向上
- 11種の配列 (サイズ#20 / #22) 20種の混合配列 (#8 / #20)
- 絶縁体:耐熱樹脂
- 防水性能
- 堅牢構造:切削加工シェル

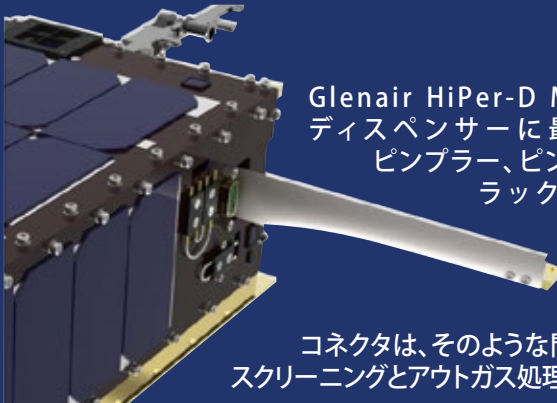
宇宙グレードDサブ HiPer-D® - 断面図



28シリーズ 宇宙グレードHiPer-D コネクタ



特長・仕様



Glenair HiPer-D M24308準拠Dサブコネクタは、小型衛星や超小型衛星の衛星ディスペンサーに最適で、そこは衛星展開前に、保持解放機構(HDRM)やピンプラー、ピンプッシャー、ドア状況センサ、システム通信や試験に使用されるラックアンドパネル方式やコネクタ付きワイヤーハーネスが取り付けられる箇所です。

ハードウェア付きDサブコネクタの標準化された使い方としては、お互いの接続と通信を簡素化することです。Glenair HiPer-Dコネクタは、そのような問題の解決に貢献します。コネクタは、NASA EEE-INST-0002に従い、スクリーニングとアウトガス処理することが可能です。

HiPer-D コネクタ vs MIL-DTL-24308		
特長 / 仕様	M24308	HiPer-D
使用温度範囲	-55°C ~ +125°C	-65°C ~ +200°C
絶縁体	熱可塑樹脂	熱硬化樹脂
シェル	銅(真鍮)	アルミ(ステンレス鋼)
耐電圧	AC 1000 V	AC 1000 V
グラウンド方法	ディンプル (MILスペックに要求なし)	ニッケルめっき銅合金 EMI バネ
耐環境性	なし	あり
正弦波振動	20G	60G
ランダム振動	要求なし	43G
衝撃	50G	300G
コネクタへのバックシェルのネジ固定	なし	あり

HiPer-D 混合配列(パワー・信号・同軸)

- サイズ #8 パワー・50Ω/75Ω 同軸コンタクト対応配列
- サイズ #8 / #20 の混合配列
- 200°C 連続使用温度
- 20 種類の配列
- 圧着コンタクト・PCB端子



HiPer-D 高速通信用コネクタ

高速データ伝送用サイズ #8 圧着コンタクト - 耐環境性非対応 Dサブコネクタ

- 堅固な切削一体加工アルミシェル
- 2~5極 (同軸・Twinax・Quadaxコンタクト)
- グラウンドプレーンタイプ (絶縁材なし)
- PCB端子形状: ストレート・ライトアングル
- スクーププルーフ非対応
- スクーププルーフ対応 → 792シリーズ参照

